

akasa®

thermal compound

ProGrade Plus T5

www.akasa.com.tw

FR

Application

- Grattez la plus grande partie du TIM avec un morceau de plastique rigide
- Nettoyez la surface avec une lingette TIM
- Laissez agir 1 à 2 minutes
- Appliquez une petite quantité de Akasa Thermal Compound sur la surface propre du chipset
- Répartissez soigneusement le composé sur toute la surface du chipset à l'aide de la spatule fournie. Remarque : un film mince est idéal - un supplément de composé n'améliorera pas les performances.
- Le dissipateur thermique ou le refroidisseur est maintenant prêt à être installé.

Données techniques

- Couleur : gris
- Viscosité : 6,000,000 (mPa.s/ 22°C)
- Conductivité thermique : 5.2 W/mK
- Plage de fonctionnement : -50°C ~ 250°C
- Résistance thermique : 0.04 °C-cm²/W @ 60 psi

AVERTISSEMENT

- Garder hors de la vue et de portée des enfants
- Éviter le contact avec les yeux ou ne pas ingérer

D

Anwendung

- Kratzen Sie den größten Teil des TIM mit einem Stück steifen Kunststoff ab
- Reinigen Sie die Oberfläche mit dem TIM Tuch
- 1-2 Minuten einwirken lassen
- Tragen Sie eine kleine Menge Akasa Thermal Compound auf die saubere Oberfläche des Chipsatzes auf
- Verteilen Sie die Paste mit dem mitgelieferten Spreizer vorsichtig auf der gesamten Oberfläche des Chipsatzes.
Hinweis: ein dünner Film ist ideal - zusätzliche Paste wird die Leistung nicht verbessern.
- Der Kühlkörper oder Kühler ist nun bereit für den Einbau.

Technische Daten

- Farbe: Grau
- Viskosität: 6,000,000 (mPa.s/ 22°C)
- Wärmeleitfähigkeit: 5.2 W/mK
- Betriebsbereich: -50°C ~ 250°C
- Thermischer Widerstand: 0.04 °C-cm²/W @ 60 psi

WARNUNG

- Außerhalb der Sicht und Reichweite von Kindern aufbewahren
- Kontakt mit den Augen oder Verschlucken vermeiden

ES

Aplicación

- Raspe la mayor parte del TIM con una pieza de plástico rígido
- Limpie la superficie con la toallita limpiadora TIM
- Deje actuar entre 1-2 minutos
- Aplique una pequeña cantidad de Akasa Thermal Compound en la superficie limpia del chipset
- Extienda cuidadosamente el compuesto en toda la superficie del chipset usando el esparcidor incluido. Nota: una película fina es ideal: añadir más compuesto no mejorará el rendimiento.
- El disipador térmico o refrigerador está listo para la aplicación.

datos técnicos

- Color: gris
- Viscosidad: 6,000,000 (mPa.s/ 22°C)
- Conductividad térmica: 5.2 W/mK
- Rango de operación: -50 °C ~ 250 °C
- Resistencia térmica: 0.04 °C-cm²/W @ 60 psi

ADVERTENCIA

- Mantener fuera de la vista y del alcance de los niños.
- Evite el contacto con los ojos o la ingestión.

PT

Aplicação

- Retire o excesso de pasta térmica antiga com um pedaço de plástico rígido
- Limpe a superfície com o TIM Wipe
- Deixe por 1-2 minutos
- Aplique uma pequena quantidade de Akasa Thermal Compound na superfície limpa do chipset (CPU, GPU)
- Espalhe cuidadosamente o composto por toda a superfície do chipset usando o espalhador incluído.
Nota: uma camada fina é ideal – Excesso de composto não melhorará o desempenho.
- O dissipador de calor ou o resfriador está pronto para instalação.

Dados técnicos :

- cor: cinza
- Viscosidade: 6,000,000 (mPa.s/ 22° C)
- Condutividade térmica: 5.2 W/mK
- Temperatura de operação: -50 ° C ~ 250 ° C
- Resistência térmica: 0.04 °C-cm²/W @ 60 psi

AVISO

- Manter fora da vista e do alcance das crianças
- Evite contato com os olhos ou ingestão

RU

Способ нанесения

- Соскребите большую часть TIM куском жесткого пластика
- Очистите поверхность прилагаемой салфеткой
- Оставьте на 1-2 минуты
- Нанесите немного термокомпаунда Akasa на чистую поверхность чипсета
- Осторожно распределите компаунд по всей поверхности чипсета с помощью прилагаемого шпателя.
- Примечание: в идеале желательно получить очень тонкий слой – лишний компаунд не улучшит производительность
- Радиатор или охладитель теперь готов к установке

Технические данные

- цвет: серый
- вязкость: 6,000,000 (мПа·с при 22°С)
- теплопроводность: 5.2 Вт/(м·К)
- рабочий диапазон: -50°С ~ 250°С
- тепловое сопротивление: 0.04°С·см²/Вт при 60 ф.лв.д.

ОПАСНО

- Храните батареи в недоступном для детей месте.
- Не допускайте контакта с глазами.

JP

使用法

- 硬いプラスチック板でTIMを可能な限り削り取ります
- TIMワイプで表面を拭き取ります
- 1~2分放置します
- 清潔なチップセット表面へ Akasa Thermal Compound を少量適用します
- 付属のへらを使用してチップセットの表面全体へコンパウンドを塗り広げます。注意：薄い膜状に塗布するのが理想的です。コンパウンドを厚く塗っても性能は向上しません。
- これでヒートシンク/クーラーを設置できます。

技術仕様

- 色：グレー
- 粘度：6,000,000 (mPa.s/ 22°C)
- 熱伝導性：5.2 W/mK
- 動作温度：-50°C ~ 250°C
- 耐熱性：0.04 °C-cm²/W @ 60 psi

警告

- お子さまの手の届かない場所に保管してください
- 飲み込んだり、目に入らないようにしてください

CN

应用

- 用硬塑料板刮掉大部分TIM
- 用TIM清洁布清洁表面
- 等待1-2分钟
- 将少量 Akasa Thermal Compound 涂在干净的芯片组表面
- 使用随附的刮刀将导热膏均匀抹在芯片组整个表面。
注：最好是薄薄的一层 - 导热膏太多并不会提高效果。
- 即可安装散热器或冷却器。

技术数据

- 颜色：灰色
- 粘性：6,000,000 (mPa.s/ 22° C)
- 导热系数：5.2 W/mK
- 工作温度范围：-50° C ~ 250° C
- 热阻：0.04 ° C-cm²/W @ 60 psi

警告

- 请妥善保管远离儿童视线和触及范围
- 避免与眼睛接触或误食